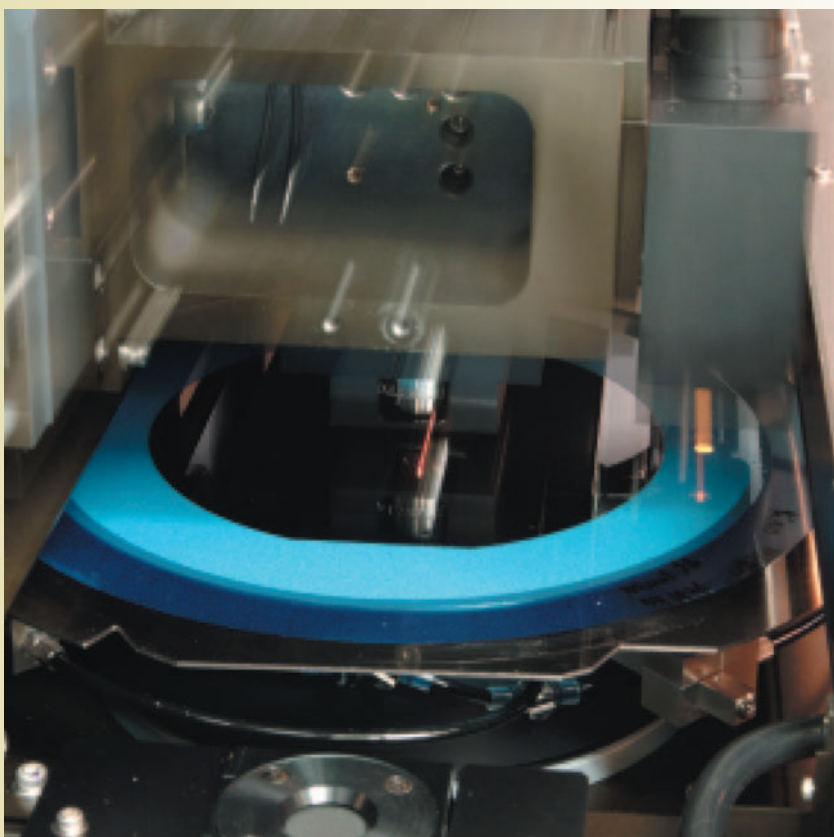




ステルスダイシング

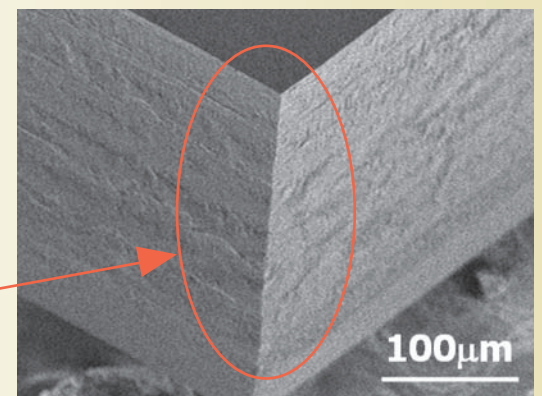
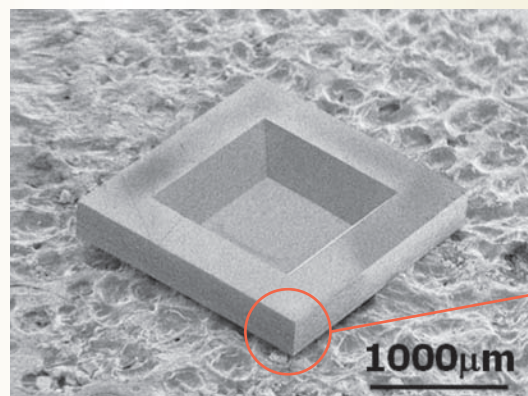
浜松ホトニクス株式会社



ステルスダイシング技術



ステルスダイシング技術は、対象材料に対して、半透明な波長のレーザー光を材料内部に集光し、分割するための起点(改質領域)を形成した後、ウェーハに外力を加え、チップ状に小片化するダイシング技術です。



既存のダイシング概念を塗り替える「ステルスダイシングの特長」

加工方式	ブレードダイシング	レーザーアブレーション	ステルスダイシング
水(冷却/洗浄)	要	要	不要
チッピング	有	有	無
発塵	有	有	無
T字・円形ダイシング	×	○	◎
高速極薄ウェーハダイシング	△	○	◎
チップ収率	△	△	◎
加工高速性	△	△	◎
デバイス熱影響	有(残留ストレス含む)	有(HAZ*)	無

*HAZ: Heat Affected Zone